

电子信息产业技术进步和技术改造投资方向

项目领域	项目名称	实施内容
一、半导体集成电路	集成电路产品设计	重点支持计算机及网络、通信、数字音视频用关键芯片,智能卡芯片、工业控制芯片、汽车专用芯片等设计
	集成电路芯片制造	重点支持 8-12 英寸生产线集成电路芯片制造
	集成电路封装测试	重点支持球栅阵列封装（BGA）、系统级封装（SIP）、芯片级封装（CSP）、方型扁平无引脚封装（QFN）、倒扣封装（flipchip）、多芯片组装（MCM）等集成电路新型封装测试
	集成电路专用材料	重点支持 8-12 英寸电子级单晶硅及硅片、光刻胶、靶材、引线框架等专用材料生产
	集成电路公共服务	重点支持集成电路公共服务平台、集成电路研发中心建设及应用服务
	半导体发光二极管	重点支持大功率、高亮度半导体发光二极管的外延片和芯片制造、封装、光源模块及相关材料等；支持半导体照明相关标准制定与公共检测平台建设
	半导体电力电子器件	重点支持功率场效应管（VDMOS）、绝缘栅双极型晶体管（IGBT）、快恢复二极管（FRD）等新型半导体电力电子器件的开发与产业化
二、平板显示和彩电	TFT-LCD、PDP 面板	重点支持规划布局内高世代 TFT-LCD 生产线建设和 PDP 生产线扩能升级
	TFT-LCD、PDP 模组与整机	重点支持规划布局内骨干企业平板模组、平板电视生产线建设，平板显示整机与模组一体化设计和制造
	OLED 显示产品	重点支持骨干企业 OLED 显示产品研发及产业化
	平板显示产业配套材料	重点支持驱动 IC、LED 背光源、玻璃基板等关键配套材料及专用设备研发和产业化
三、通信设备	TD-SCDMA 移动通信系统	重点支持 TD-SCDMA（增强型）及后续演进技术的系统、终端、核心芯片及测试设备产业化，研发测试环境及业务平台建设
	高速智能光网络	重点支持高速远距离智能光网络设备的产业化

三、通信设备	FTTx 光纤接入系统及关键器件	重点支持 FTTx 系列光纤接入产品、高速光收/发模块、光电耦合器件、光有源器件、光电交换器件以及光无源器件和 MEMS 光开关等光通信器件的开发和生产
	宽带无线接入系统	重点支持具有自主知识产权的宽带无线接入系统、终端及核心芯片研发及产业化，推动新一代宽带无线接入技术(含数字集群功能)在重点领域的行业应用
四、数字音视频	高清播放系统及关键件	重点支持基于自主音视频标准的高清播放系统及关键件的研发及产业化
	数字电视前端设备	重点支持数字电视发射设备、演播室设备等数字电视前端设备的研发及产业化
	数字电影设备	重点支持高清数字投影机及关键件、数字音响系统等数字电影设备的研发及产业化
	数字电视终端	重点支持数字电视接收机设备(含一体机)、微型投影机、IPTV(网络电视)等终端产品的研发及应用
	数字电视公共服务平台	重点支持基于自主音视频标准的数字电视内容综合服务平台建设，建立数字电视专利池，制定和完善相关配套标准
五、计算机产业及下一代互联网	便携式计算机	重点支持优势企业笔记本电脑研发中心建设，以及便携式计算机产品自主设计生产、关键零部件和配套件研发产业化
	高性能计算机、服务器、工业控制计算机	重点支持服务器研发中心建设；高性能计算机、中高端服务器、海量存储设备、嵌入式计算机、工业控制计算机及检测产品等的自主设计生产
	计算机外部设备及耗材	重点支持打印机、扫描仪、移动存储、投影仪、多功能一体机等外部设备及关键零部件生产；环保彩色墨水、彩色照片喷墨纸开发生产；再生墨/粉盒生产线改扩建
	下一代互联网设备及应用	重点支持兼容 IPV4/IPV6 的网络互联设备、多媒体终端、网络安全设备、管理和计费设备、无线移动互联网设备、传感器网络设备、物联网开发生产及应用
	自主 CPU 计算机产业化及应用	重点支持采用自主 CPU 研制高性能计算机、低成本计算机、行业应用终端、税控收款机、工控机、数控系统等产品生产
五、计算机产业及下一代互联网	数字化 3C 产品	重点支持新型数字化消费电子产品(数字相机、电子书、手机电视、导航终端等)、闪联产品(计算机、电视、投影仪、网关等)、WAPI、数字家庭等产品自主研发、产业化及应用
	应用电子产品与工业监控系统	重点支持电子标签(RFID)、汽车电子、机床电子、医疗电子、金融电子、工业控制及检测等产品的开发、产业化及推广应用

六、软件、信息服务和信息安全	嵌入式软件	重点支持智能手机嵌入式软件、汽车电子嵌入式软件、车载信息系统软件的研发环境和服务保障体系建设
	数字内容	重点支持数字内容加工处理的工具、平台、环境和公共服务能力建设,支持动漫游戏等产业发展
	重点行业软件研发和示范应用	重点支持企业管理、产品研发、生产制造等领域的应用软件以及行业解决方案的研发和产业化。支持工业、农业以及政府部门、公共服务等重点领域国产软件的示范应用
	软件与信息技术服务公共平台	重点支持协同研发、标准研制及验证、软件测试与质量保障、知识产权保障、人才培养等行业公共服务支撑能力建设。建立涵盖共性技术、标准验证、软件评测、知识产权、培训共享等平台资源库。搭建分布式资源、共性技术应用、应用服务等共享环境。支持基于 SaaS 等模式的开放共享服务
	应用及管理软件公共服务平台	重点支持工业自动化软件研发与测试平台、汽车电子软件研发及测试平台、车载信息系统软件研发联调平台、企业管理软件研发及测试平台、信息系统集成多项目管理平台、信息系统工程监督管理平台、数据托管服务平台等
	信息安全与服务	重点支持防火墙、安全隔离与信息交换、通信安全、信息安全审计与监控、统一威胁管理、入侵检测/入侵防御等系统安全产品,以及网站恢复、数据备份恢复、安全操作系统、安全数据库、移动存储安全产品、可信计算等数据安全产品开发和产业化;支持系统设计、咨询、评估、检测、认证等信息安全服务业发展
七、电子基础产品	微小型表面贴装元器件	重点支持超小型片式多层陶瓷电容器、片式电解电容器、片式钽电容器、片式电感器、片式压电陶瓷频率器件、片式压电石英晶体器件、集成无源器件等研发和产业化
	其他新型电子元器件	重点支持汽车传感器、MEMS 传感器及其他新型、高性能传感器,支持声表面波器件、微波介质器件等高频频率器件和无刷化、智能化的微特电机等研发和产业化
	高端印制电路板及覆铜板材料	重点支持高密度互联多层印制电路板、多层挠性板、刚挠印制电路板、IC 封装基板、特种印制电路板;鼓励节能减排工艺发展,重点发展环保型的高性能覆铜板、特殊功能覆铜板、高性能挠性覆铜板和基板材料等研发和产业化
	新型绿色电池及材料	重点支持大容量、高可靠性锂离子电池和聚合物锂离子电池,氢动力电池,锂离子电池高性能/低成本正负极材料、高性能隔膜材料等研发和产业化

其他新型电子材料	重点支持电子级多晶硅材料、高性能磁性材料、电子功能陶瓷材料等研发和产业化
电子专用设备及测量仪器	重点支持新型电子元器件专用设备、半导体和集成电路专用设备、多晶硅和单晶硅专用设备、太阳能电池专用设备、新型显示器件专用设备，通信测试仪器、数字音视频及数字电视测试仪器、半导体和集成电路测试仪器、电子基础测试仪器等研发和产业化